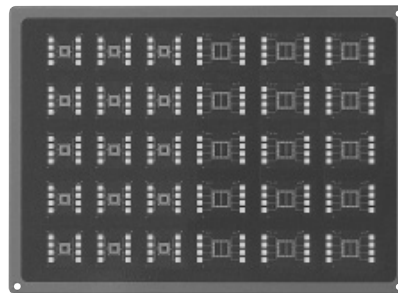


Series: **ALIVH[®]**

Japan

Type: **ALIVH[®] Cタイプ**

ALIVH[®] Gタイプの上に、めっきプリントなどによって順次絶縁層、導体層を積み上げていく製法（ビルドアップ法）により、ファインパターン層を形成した全層IVH構造の樹脂多層プリント配線板



■ 特長

- 小形軽量・高密度配線
- 表層ランド強度がALIVH[®] Gタイプより高い
- RoHS対応

■ 主な用途

- 携帯電話
- ビデオカメラ
- デジタルスチルカメラ

■ 基本性能

項目	ALIVH [®] Cタイプ	
基板材料	ガラス織布エポキシ樹脂	
基板厚み (標準) mm	0.80~0.95 (1+6+1)	
ビア径	μm	ALIVHベース基板 最小 150 ビルドアップ層 最小 135
ピアランド径	μm	ALIVHベース基板 最小 275 ビルドアップ層 最小 275
線幅/線間	μm	ALIVHベース基板 最小 60/70 ビルドアップ層 最小 75/75
誘電率(1 GHz)	—	4.6
密度	g/mL	2.0

■ 取得規格

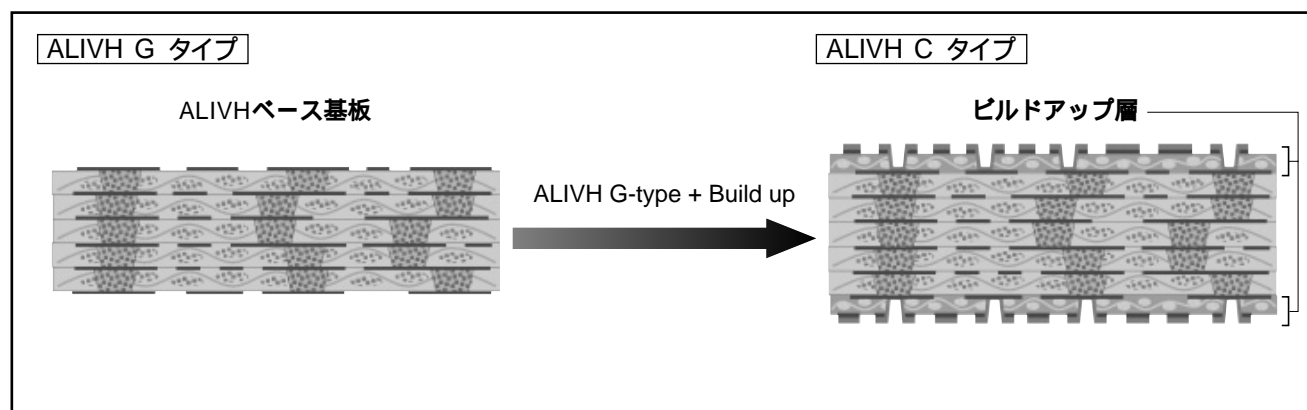
UL規格 (File No. E36779)

● Type : ALIVH[®] Cタイプ

生産地	UL品番	難燃性	基 材	導 体			はんだ付け 定格 (°C), (秒)	定格温度 (°C)
			ANSI Grade	最小導体幅 (mm)	最小エッジ 導体幅 (mm)	最大導体幅 (mm)		
日本	EBKN7	94V-0	FR-4	0.025	0.05	19.8	270, 20	105

上表の数値はUL取得内容であり、設計を示す数値ではありません。

■ 構造図



“ALIVH[®]” は日本国登録商標です。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願ひ、それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いいたします。なお、本製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知をいただき、必ず技術検討をしてください。